

McDry www.mcdry.eu

Feuchtigkeitsschutz für Ihre IC-Bausteine

Bei Lagerschrank mit extrem niedriger Luftfeuchtigkeit entfällt der Trocknungsprozess

Entspricht IPC/JEDEC J-STD-033B.1

Lagerung mit extrem niedriger Luftfeuchtigkeit (1%RL)



MCU-201

MCU-301

MCU-401



DXU-1001

DXU-580SF

Merkmale:

Die Lagerung von IC-Bausteinen in McDry-Schränken nach der Entnahme der IC-Bausteine aus MBBs kann die Bildung von Mikrorissen verhindern. Somit ist eine Trocknung nicht mehr erforderlich. Durch das effiziente Trockenmittel ist kein Stickstoff mehr erforderlich. Feuchtigkeitsempfindliche Bausteine jeglicher Art können in den Schränken gelagert werden.

Es gibt drei verschiedene Modellausführungen, mit denen Luftfeuchtigkeitswerte von 1%RL und 3%RL problemlos gehalten werden können.

www.mcdry.eu

SEIKA SANGYO GMBH
Heltorfer Straße 16, D-40472 Düsseldorf
Phone: 0049/(0) 21141580 Fax: 0049/(0) 2114791428
E-mail: info@seika-germany.com

ASW GmbH E-cube Deutschland
Phone: 0049/(0) 53448039911 Fax: 0049/(0) 53448039928
E-Mail: info@asw-handling.de

ANS anwer elektronik Service- & Vertriebs GmbH

Flying Prober

14 mobile Testressourcen

Der doppelseitige, vertikale Flying Prober Pilot V8 von Seica verfügt über insgesamt 14 mobile Testressourcen (8 Testprobes, 2



Open Fix Probes, 2 Power Probes, 2 Kameras). Dieser hochflexible voll ICT- und FT-fähige Flying Prober bietet zusätzliche

Boundary Scan- und On-Board-Programming-Fähigkeiten. Dies wird durch die vertikale Architektur und ein neuartiges Klemmsystem erreicht, das ein oszillieren der Baugruppe beim Testes vermeiden und somit ein höchstpräzises, wiederholbares Kontaktieren ermöglicht.

lieren der Baugruppe beim Testes vermeiden und somit ein höchstpräzises, wiederholbares Kontaktieren ermöglicht.

 www.all-electronics.de **542pr0508**
▶ Link zu Seica

Mehrdimensionale Leiterplatten

Wirtschaftliche Alternative

Die von Häusermann entwickelte Technologie HSM Tec bietet eine wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen Starrflex Lösungen. Durch das Verlegen von Runddrähten und Profilen unter der ersten Lage (Außenlage) wird eine elektrische Verbindung zwischen zwei oder mehreren Schaltungseinheiten hergestellt. Die Drähte und Profile werden durch eine etablierte Ultraschallverbindungstechnik stoffschlüssig in die Signalführung einer Baugruppe integriert. Nach Fertigstellung der Multilayer Leiterplatte werden mittels Tiefenfräsungen die Sollbiegestellen für die Biegung gesetzt. Durch die eingesetzte Kerbfräsung kann der Abstand zwischen den starren Teilen nahezu Null betragen. Die Verbindung ist für die Anwendung bei großen Temperaturschwankungen

von z. B. -40°C bis +155°C, Vibration und Schock qualifiziert und vielfach erprobt. Mit einer einzelnen Kerbfräsung ist ein Biegewinkel von 90° realisierbar. Eine Biegung von 180° kann durch zwei oder mehr Kerben erreicht werden. Die Technologie ist für das einmalige Biegen an definierten Stellen sowie leichte Justierbewegungen im Zuge der Endmontage geeignet. Die großen Querschnitte der Drähte und Profile (Draht 0,5 mm Durchmesser, Profile mit 2,0 x 0,5 bzw. 4,0 x 0,5 mm²) ermöglichen zusätzlich die Übertragung hoher Ströme, sowohl auf den starren, als auch auf den flexiblen Teilen. Auf einem Kupferdraht von 0,5 mm Durchmesser können bei einem lateralen Abstand von 1 mm zu den übrigen Strukturen, je nach Aufbau, bis zu 10 A übertragen.

 www.all-electronics.de **532pr0508**
▶ Link zu Häusermann